



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 最高工作结温达150°C，正向压降小

典型应用

- 仪器设备的直流电源，PWM变频器的输入整流电源
- 直流电机励磁电源，开关电源的输入整流
- 软启动电容充电，电气拖动和辅助电流
- 逆变焊机，电流充电直流电源

I _D	10A
V _{RRM}	600-2000V
I _{FSM}	1.2 KA
I ² t	7.2 10 ³ a ² s

符号	参数	测试条件	结温 T _J (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I _D	直流输出电流	单相全波整流电路, T _C =100°C	150			10	A
V _{RRM}	反向重复峰值电压	V _{RRM} tp=10ms V _{RSM} =V _{RRM} +200V	150	600		2000	V
I _{RRM}	反向重复峰值电流	at V _{RRM}	150			2	mA
I _{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 V _R =0.6V _{RRM}	150			1.2	KA
I ² t	浪涌电流平方时间积					5.2	A ² S*10 ³
V _{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r _F	斜率电阻					5.0	mΩ
V _{FM}	正向峰值电压	I _{FM} =15A	25			1.05	V
R _{th(j-c)}	热阻抗(结至壳)	单面散热				0.20	°C/W
R _{th(c-h)}	热阻抗(壳至散热器)	单面散热				0.15	°C/W
V _{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, I _{iso} :1mA(max)		2500			V
F _M	安装扭矩(M5)				4		N·m
	安装扭矩(M6)				6		N·m
T _{stq}	存温度			-40		125	°C
W _t	质量						g
Outline	外形						

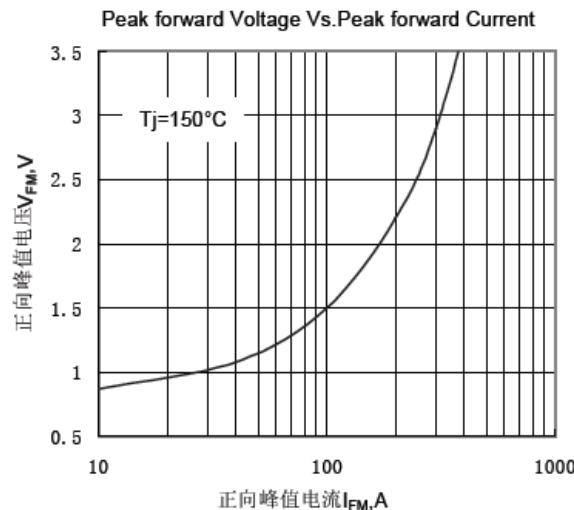


Fig.1 正向伏安特性曲线

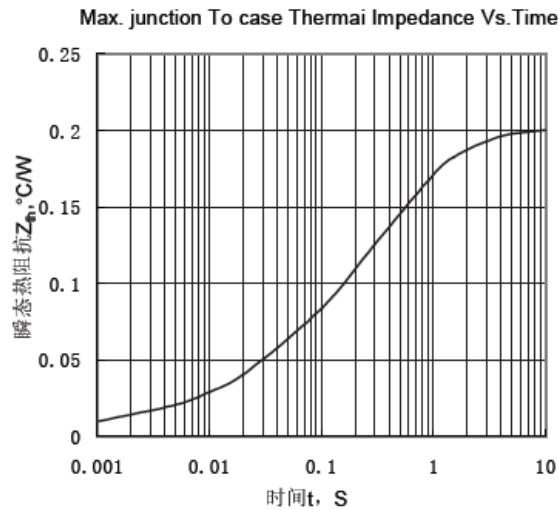


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

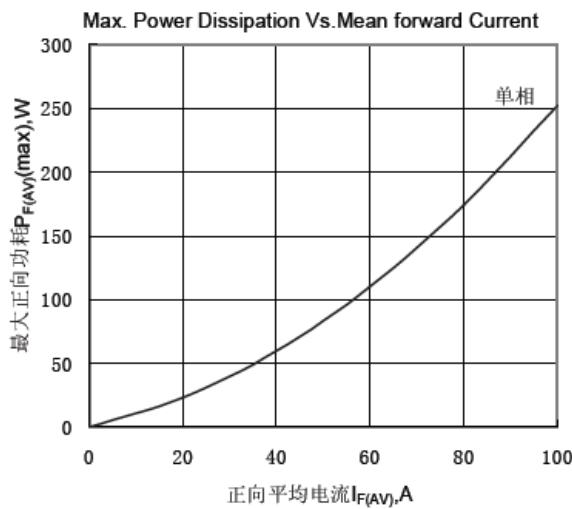


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

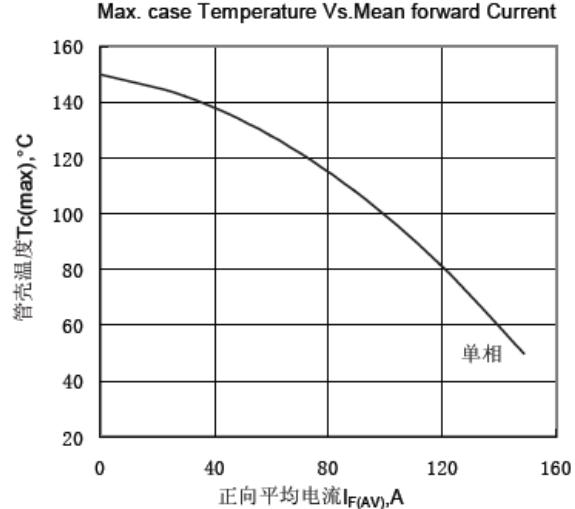


Fig.4 管壳温度与平均电流关系曲线

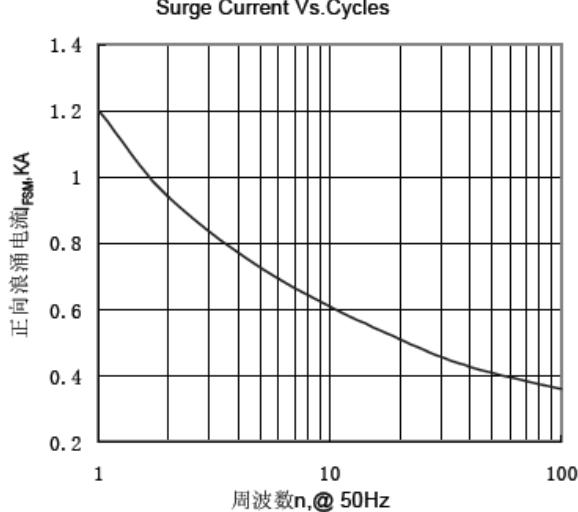


Fig.5 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

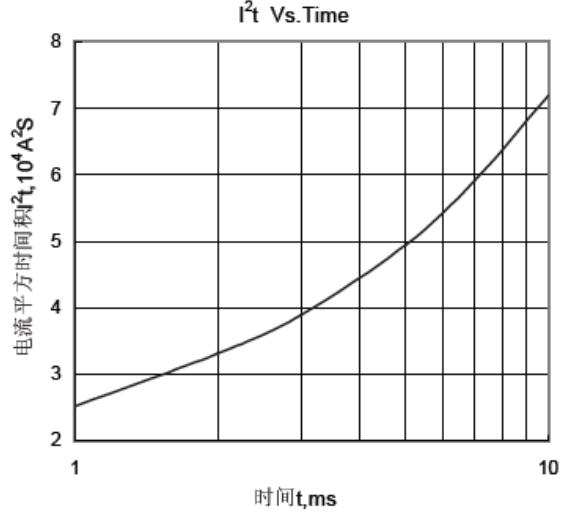


Fig.6 I^2t 特性曲线



外形图：

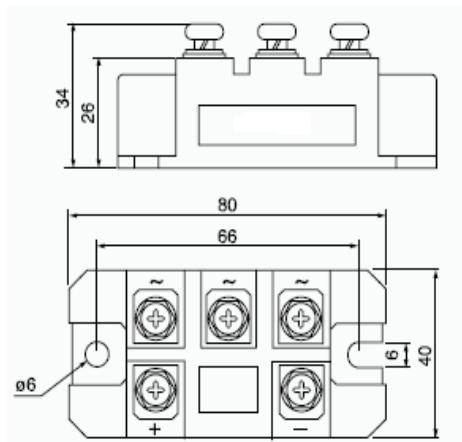


图 1

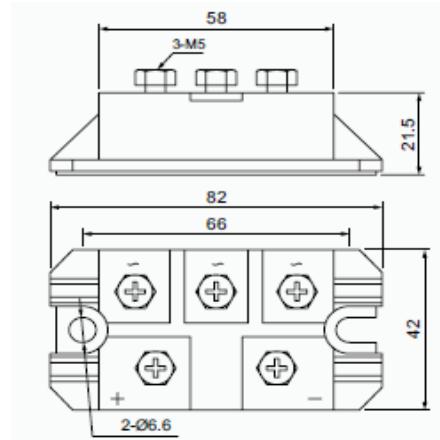


图 2

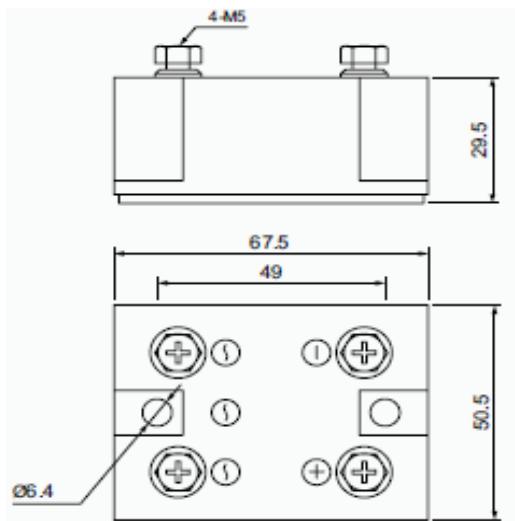


图 3

